

CATEGORIA : **FLUXO LÍQUIDO NO - CLEAN**
NOME : **CX 51**

CARACTERÍSTICAS

- Livre de Resinas
- Livre de Halogêneos
- Aplicado por espuma, spray ou imersão
- Reduz curtos (bridging)
- Aumenta a molhagem

DESCRIÇÃO

CX 51 faz parte da nova geração de fluxos no-clean desenvolvidos para processos de soldagem a onda, especialmente para aumentar a molhagem e prevenir curtos. Baseado na série 2151, o fluxo CX 51 apresenta o mesmo nível de ativação, como também baixa tensão superficial em relação a outras composições existentes. CX 51 possui excelente performance sobre superfícies de cobre, estanhadas e coberturas orgânicas do PCB, deixando baixos resíduos após soldagem. Estes resíduos não são condutivos e atendem aos requisitos **Bellcore** ou **IPC**.

PROPRIEDADES FÍSICAS

SÓLIDOS (%) 1,8 ± 0,1	DENSIDADE (g/cm³) 0,803 ± 0,003	NÚMERO ÁCIDO (mgKOH/g) 13,86 ± 0,77
--	---	--

MANUSEIO

- CX 51 tem validade de 1 ano quando permanecer em sua embalagem original devidamente lacrada.
- Não estocar perto de fogo ou calor. Manter protegido da luz solar para evitar a degradação do produto
- CX 51 é fornecido pronto para uso. Não é necessário agitar.
- Não misture fluxo usado com novo na mesma embalagem.

APLICAÇÃO

Preparação inicial: É importante que o processo seja iniciado de acordo com as especificações de soldabilidade e contaminação iônica (máxima de 5 µg / pol² .) Os montadores devem estabelecer com seus fornecedores tais especificações e checá-las a cada recebimento.

Deve-se tomar cuidado no manuseio das placas durante o processo, sendo recomendado o uso de luvas limpas, além disso, na aplicação por espuma, se houver a troca do fluxo, sempre trocar a pedra porosa do fluxador por outra limpa. A pedra retirada deverá ser bem lavada com o diluente a fim de ser reutilizada. Os pallets e a esteira transportadora também deverão ser limpos sistematicamente com o diluente.

APLICAÇÃO

O fluxo está pronto para uso e pode ser aplicado por: espuma, spray e imersão.

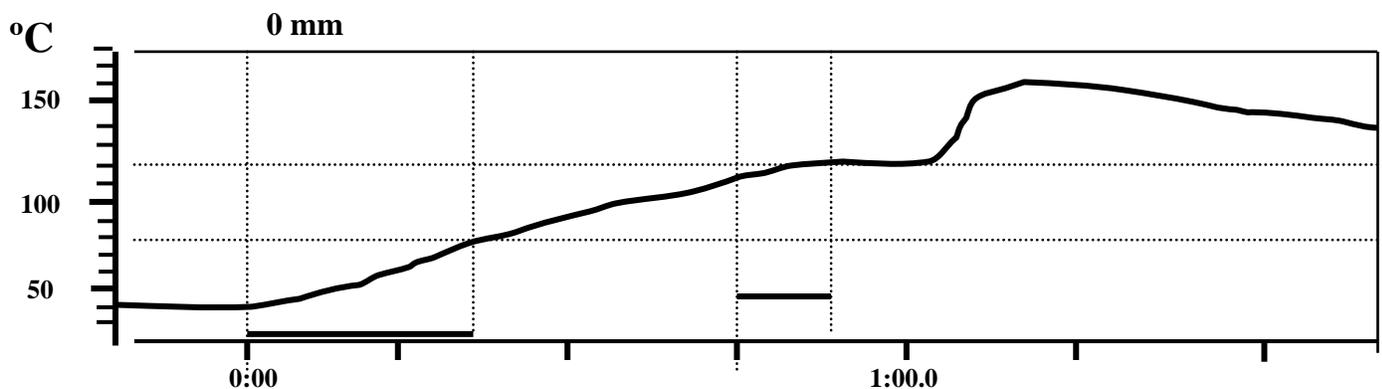
No processo por spray é importante que a quantidade de fluxo aplicada cubra uniformemente a placa. Em máquinas a onda, que empregam aplicação de nitrogênio, é necessário maior quantidade de fluxo na placa para compensar a perda por evaporação devido a extensão do equipamento.

Na aplicação por espuma, o ar utilizado pela pedra porosa deverá estar livre de água, óleo e outras misturas. **O tanque de fluxo deverá ser mantido sempre no nível suficiente para que o fluxo esteja de 30 a 40 mm acima da pedra porosa.** Ajustar a altura da espuma para que as bolhas sejam uniformes para otimizarem o processo. Durante a aplicação ocorre a evaporação do fluxo (perda de solvente), alterando suas características originais. Periodicamente será necessária a adição do Diluente Cobix C-7000 (reposição do solvente).

A correção através do uso de densímetro não é eficiente para fluxos de baixos teores de sólidos. Para maior segurança na aplicação por espuma, recomendamos que a correção seja controlada pelo teor de sólidos, que deverá estar entre 1,7 a 1,9 %, que corresponde a um índice de acidez entre 13,09 a 14,63 mg KOH/g. Para a correção do teor de sólidos empregar o **Kit Cobix para Titulação (Vide Procedimentos e Tabelas de Correção em Anexo).**

Recomendamos que o teor de sólidos seja monitorado a cada 2 horas e, para uma performance de soldagem consistente, substituir o fluxo usado a cada 40 horas de operação ou quando o teor de sólidos não puder ser corrigido pela adição do diluente. Na substituição do fluxo, o tanque e o fluxador deverão ser limpos com diluente.

PERFIL TÉRMICO



TAXA DE ELEVAÇÃO 2 a 3° C / Seg Máx	PROSSEGUIMENTO 65°C a 80°C	TEMP. PARTE SUPERIOR PCI 90°C a 115°C	RESFRIAMENTO ≤ 4°C
	≤ 40SEGUNDOS	ANTES DA ONDA	

NOTA: A temperatura da parte inferior da PCI, deverá estar entre 120°C a 165°C.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

PROBLEMAS

CAUSAS PROVÁVEIS

Curtos	:	Falta de fluxo, excesso de calor no pré aquecimento, alta velocidade, contaminação da solda.
Solder Balls	:	Baixa temperatura do pré aquecimento, excesso de fluxo.
Resíduos brancos	:	Excesso de fluxo, contaminação do fluxo, contaminação da solda.
Juntas opacas	:	Contaminação da solda, contaminação do circuito / componentes, excesso de aquecimento.

LIMPEZA

Os resíduos após soldagem, se desejável, podem ser removidos com o Removedor Cobix 12000.

CUIDADOS COM A SAÚDE

- Inalação: A inalação dos vapores ou ingestão poderá causar dores de cabeça, náuseas, dores musculares e irritação nos olhos.
- Contato com a pele: Remover os resíduos com álcool comum e lavar com água e sabão.
- Contato com os olhos: Lavar com água por 20 minutos.
- Ingestão: beba bastante água e procure o médico.
- Para maiores informações, consultar a Ficha de Segurança do Produto.